证券代码：688300　　证券简称：联瑞新材　　公告编号：2026-074

转债代码：118064　　转债简称：联瑞转债

江苏联瑞新材料股份有限公司

关于签署投资协议暨对外投资进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

投资标的名称	联瑞新材（四川）有限公司（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）；半导体封装用高性能粉体材料项目。
投资金额（万元）	100,000.00
投资进展情况	□完成　□终止　□交易要素变更　√进展
特别风险提示（如有）	公司将根据本次对外投资事项实际进展情况，按照相关法律法规的规定，及时履行信息披露义务。请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资基本情况

江苏联瑞新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 10 月 27 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于通过设立子公司实施对外投资的议案》，同意公司在四川省乐山市井研县石家桥工业园建设“半导体封装用高性能粉体材料项目”，项目总投资 10 亿元人民币，项目分两期建设，一期项目投资总额约 6 亿元，二期项目将视市场情况以及一期的达成情况等因素动态调整，最终以实际建设情况为准。同时，为满足项目建设及运营需要，公司拟在四川省乐山市井研县石家桥工业园新设子公司“联瑞新材（四川）有限公司”（暂定名，以市场监督管理部门核准为准）作为项目实施主体，注册资本为 15,000 万元。具体内容详见公司于 2026 年 10 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

披露的《江苏联瑞新材料股份有限公司关于通过设立子公司实施对外投资的公告》（公告编号：2026-071）。

二、本次对外投资进展情况

近日，公司与乐山市井研县人民政府签订了《半导体封装用高性能粉体材料项目投资协议书》，主要内容如下：

（一）协议主体

甲方：井研县人民政府

乙方：江苏联瑞新材料股份有限公司

（二）项目概况

1、项目名称：半导体封装用高性能粉体材料项目（以下简称“本项目”）。

2、投资金额：本项目计划总投资约 10 亿元人民币。分两期建设，其中一期项目总投资约 6 亿元人民币。

3、建设内容：本项目规划建设以功能性先进粉体材料生产为主的现代化生产基地，一期项目建成后将形成年产 30000 吨半导体封装用球形无机粉体的生产能力，二期项目将视市场情况以及一期的达成情况等因素动态调整，最终以实际建设情况为准。

4、项目选址：四川省乐山市井研县石家桥工业园。

5、用地面积：本项目计划用地总面积约 160 亩（实际用地面积以最终土地权属登记面积为准）。

6、建设周期：预计为 24 个月。其中一期项目自开工之日起 12 个月内完成建设并投产（投产指产品下线）。

7、项目效益：一期项目全面达产后，将形成年产 30000 吨半导体封装用球形无机粉体的生产能力。

（三）甲方权利与义务

1、甲方成立项目工作专班，统筹协调推进项目实施，积极协助乙方办理项目建设所需的相关手续，确保各项手续完备、程序合规、办理顺畅，保障项目高效有序推进。

2、甲方负责本项目建设用地的出让前期相关事宜，及时启动土地出让程序，并负责将燃气、电力、给水、排水、通信等管线接通到项目红线边界，红线边界外的管线建设费用和日常运维由甲方承担。

3、甲方依法依规对本项目行使管理职责，督促乙方严格按照国家法律法规及本协议约定履行义务，确保项目规范建设、安全运营。对乙方在建设运营过程中遇到的困难和问题，甲方应积极协调解决。

4、甲方积极协调燃气资源，支持乙方持续生产经营。

（四）乙方权利与义务

1、乙方成立项目工作专班，依法依规办理项目建设所需的各项审批手续，及时提交真实、完整、有效的申报材料，配合甲方及相关部门完成审查审批工作，确保项目手续齐全、合法合规开工建设。

2、乙方应合理规划本项目建筑外观和功能布局，与周边环境及园区整体风貌相协调，严格遵守园区管理规定，切实履行环境保护、安全生产、节能减排等主体责任，做到依法经营、诚实守信、照章纳税。

3、乙方承诺项目投资达到井研县现行工业用地“标准地”管理办法中关于固定资产亩均投资强度要求，满产后达到亩均税收要求。

（五）违约责任

1、任何一方单方面违反本协议约定的，应当根据法律法规的规定承担相应违约责任。

2、如因不可抗力因素或国家宏观政策调整等造成本协议无法履行，双方可协商解除本协议，互不承担违约责任。

3.本协议产生争议时，双方应友好协商解决；若协商不成，任何一方均有权依法提起诉讼。

（六）附则

1、双方对本协议内容负有保密义务，除法定披露义务外，未经对方同意，不得向任何第三方披露或泄露。

2、本协议自双方法定代表人或授权代理人签字并盖章之日起生效。

3、本协议一式肆份，双方各持贰份。

三、对公司的影响及拟采取的应对措施

（一）项目审批与土地获取风险

项目审批存在不确定性、延期、终止等风险：目前项目建设用地尚未取得，土地使用权能否竞得、土地使用权的最终成交价格及取得时间尚存在不确定性。项目建设所需项目备案、节能审查、环评审批、建设规划许可、施工许可等前置

审批手续，受政策调整、审批时间等因素影响，存在审批进度不及预期、办理周期延长，导致无法按照公司预计时间开工建设及按期完工。

（二）资金筹措风险

本次对外投资资金来源包括但不限于公司自有资金、自筹资金、银行贷款及其他符合法律法规规定的方式，若未来金融市场环境发生波动，如利率上升、信贷政策收紧等，可能导致自筹资金成本增加，从而对项目的整体经济性产生不利影响，存在融资成本上升的风险。

（三）投资规模与效益风险

本项目投资规模、建设周期等均为计划数或预计数，并不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成对投资者的业绩承诺。公司将根据项目实际进展情况按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《江苏联瑞新材料股份有限公司章程》等相关规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

（四）应对举措

本次签订《半导体封装用高性能粉体材料项目投资协议书》是公司落实原有投资规划、推动项目实施的重要举措，符合市场发展趋势及公司发展战略，有利于公司把握先进封装、高性能高速基板的市场机遇，进一步提升市场份额从而提升综合竞争力。公司将合理规划资金使用节奏，配备充足的资源确保项目建设和后续经营正常运行。本次投资不存在损害公司、公司股东，特别是中小股东利益的情形。

特此公告。

江苏联瑞新材料股份有限公司董事会

2026 年 11 月 13 日